

Caneta Retrabalho_S_956_NC

FLUXO DE SOLDA NO-CLEAN

(Fluxo de Solda Baixos Sólidos, No-Clean)

Informações Gerais

Fluxo orgânico livre de haletos e limpeza pós soldagem, projetado para solda convencional e SMT para placas de circuito. A natureza do ativador resulta em sistemas com praticamente nenhum resíduo deixado na montagem após a solda. As placas saem limpas após a soldagem. Não há nenhum resíduo para interferir com o teste elétrico, e a limpeza é eliminada.

Com a redução dos componentes, placas mais densa (maior quantidade de componentes) e placas produzidas com o processo de ar quente (HASL), as mesmas ficam com os contatos elétricos expostos, interferindo na soldagem dos componentes. Com isso, esse fluxo foi desenvolvido para atender essa necessidade do processo produtivo.

Este fluxo foi desenvolvido para ajudar na tensão superficial no processo de soldagem, maior oxidação nos contatos dos componentes Lead Free e alta complexidade das funções elétricas agregadas aos componentes.

Fluxo é satisfatório para a indústria automotiva, PCs, telecomunicações e outras aplicações onde considerações de confiabilidade sejam críticas.

Essa fórmula possui melhores características na juntas de solda, melhor molhagem e inibindo a corrosão da solda inerente ao processo Lead Free. Tem ainda como característica menor odor associado ao processo de soldagem.

Aplicação

O fluxo pode ser aplicado através de equipamento de fluxagem por espuma ou spray. Pode ser usando também para retrabalho em placas de circuito impresso. Durante aplicação, o fluxo proverá uma frente de bolhas uniformes e estáveis.

Para assegurar uma boa aplicação da fluxagem ou spray, deve-se assegurar uma boa filtragem do ar comprimido, evitando assim partículas de sujeira ou água da tubulação, que pode reduzir a eficiência do fluxo durante o processo de soldagem. Após o fluxo, uma lâmina de ar deverá ser usada para remover o excesso de fluxo.

A temperatura de pré-aquecimento recomendada para montagens em placas de circuito é de 195-220°F (90-105°C) medida na face de componente da placa. A combinação do projeto da placa, duração de contato com da solda, forma de onda de soldagem ou tempo de pré-aquecimento podem afetar a temperatura de pré-aquecimento e os parâmetros desejados para uma melhor soldagem. O fluxo também pode ser aplicado por spray ou fluxagem por onda.

Características

- ◆ Resíduo por soldagem quase incolor
- ◆ Livre de halogênios
- ◆ Melhora o aspecto de soldagem
- ◆ Resíduos não condutivos e não corrosivos são eliminados, reduzindo custos de limpeza
- ◆ Redução do odor associado ao processo de soldagem
- ◆ Frente de onda de espuma uniforme e estável no equipamento de fluxagem
- ◆ Conforme a especificação Bellcore TR-NWT-000078 (emissão 3/12/1991)

O controle da fluxagem durante o uso é necessário para assegurar uma quantidade consistente de fluxo a ser aplicado nas placas. Uma menor quantidade de resíduos remanescentes após a soldagem, reduz interferência no teste elétrico e os resultados de solda mais consistentes. A natureza complexa do sistema solvente para o fluxo faz com que seja necessária a utilização de Thinner #4600, seja usado para repor as perdas evaporativas.

Controle de Processo

Os resíduos das placas de circuito e linhas de ar podem acumular-se no tanque de fluxo durante o uso. Quando excessivo isto se deposita em placas de circuito que podem formar acúmulo de resíduo em agulhas do teste in circuit (ICT). É necessário substituir o tanque de fluxo com fluxo novo quando resíduos em excesso acumularem-se no tanque de fluxo.

Inspeção da solda nas placas de circuito e componentes é aconselhada como parte do controle de processo para manter resultados de solda consistentes.

Propriedades Físicas

	<u>#TS CR Tin/Lead NC</u>	<u>#4600</u>
Gravidade Específica @ 76°F (25°C)	0.812 ± 0.005	0.805 ± 0.003
%. de sólidos, % (teste 2.3.34 como IPC-TM-650)	3,1	---
pH (5% solução)	3.4	---
Número Ácido, mgKOH/gm	21.4 ± 2	---
Conteúdo de Haletos	nenhum	---
Teste – Corrosão Copper Mirror	aprovado	---
Teste de Corrosão 2.6.15 como IPC-TM-650	aprovado	---
Resistência de Isolação Superficial* @85°C (185°F), 85% umidade como IPC-TM-650, Método 2.6.3.3	2,24 x 10 ¹⁰ ohms	---
Flash Point (T.O.C.)	18°C (65°F)	16°C (60°F)
Temperatura de Auto-ignição	399°C (750°F)	399°C (750°F)

*SIR do controle não soldado = 5 x 10⁹ ohm
 * Resistência de Isolação na Superfície (SIR) Atingirá o requerido no padrão Bellcore TR-NWT-000078 para a resistência de isolação superficial para placas de telecomunicações. Uma resistência de isolação maior do que 1 x 10⁵ megohm (10¹¹ ohm) pode ser obtida sem limpeza.

$$\{ \text{Necessidade: } IR_{\text{MEDIA}} = (10^5 \times IR_A) \div (10^5 \times IR_A) \}$$

Armazenamento

Este produto é inflamável e deverá ser armazenado ou guardado longe de fontes de calor e ignição.

Saúde e Segurança

Este produto, durante manuseio ou uso, pode ser prejudicial à saúde ou ao meio ambiente. Leia a Folha de Dados de Segurança do Produto (MSDS) e rótulos de alerta antes de utilizar este produto.